

实现180° 自由动作, 本体厚1mm.



主要规格

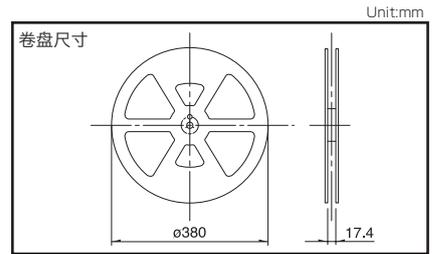
项目		规格
最大额定/最小额定 (电阻负载)		1mA 5V DC / 50 μ A 3V DC
接触电阻 (初期/寿命后)		2 Ω max. / 5 Ω max.
动作力		0.35N max.
操作寿命	无负载	50,000 cycles
	负载	50,000 cycles (1mA 5V DC)

产品一览

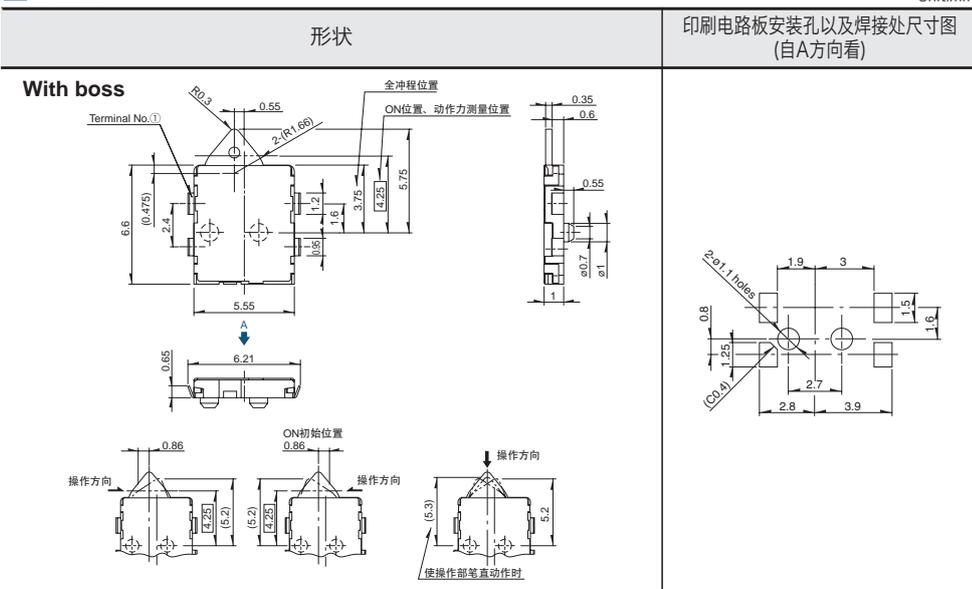
电路数	接点数	端子形状	定位销	最小订货单位 (pcs.)		产品编号
				日本	出口	
1	1	For PC board (Reflow)	有	5,000	20,000	SPVL110102
			无			SPVL120101

包装规格
载带

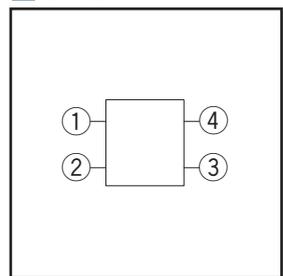
包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1 卷	1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装		
5,000	10,000	20,000	16	417×409×139



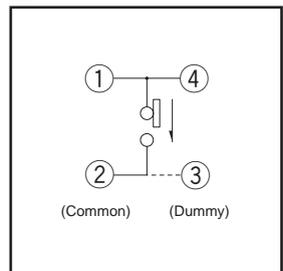
外形图



端子排列 (自A方向看)



电路图



注

外形图表示的是有定位销的产品类型。

检测开关

产品系列一览

系列		通用型			
		SSCQ	SSCM	SPVL	SPPB
照片					
动作形式		2方向 单侧2段	2方向	3方向	1方向 2方向
外形尺寸 (mm)	W	3.8	5	5.55	6.3
	D	3.6	4	6.6	3
	H	0.9	1.5	1	4.9
使用温度范围		-10°C to +60°C		-40°C to +85°C	
车用产品		—	—	●	●
生命周期					
电路数 / 接点数		1 / Two-direction type: 2-position each side	1/2	1/1	
最大额定 (电阻负载)		1mA 5V DC			0.1A 30V DC
最小额定 (电阻负载)		50μA 3V DC			
耐久性能	无负载寿命	50,000cycles 5Ω max.			50,000cycles 2Ω max.
	负载寿命 最大额定 (电阻负载)	50,000cycles 5Ω max			50,000cycles 2Ω max.
电性能	初期接触电阻	2Ω max.			1Ω max.
	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC			
	耐电压	100V AC for 1 minute			
机械性能	端子强度	0.5N for 1minute		1N for 1minute	3N for 1minute
	操作部强度	1N	2N	5N	10N
耐环境性能	耐寒性能	-20°C 96h		-40°C 500h	
	耐热性能	85°C 96h		85°C 500h	
	耐湿性能	40°C, 90 to 95%RH 96h		60°C, 90 to 95%RH 500h	
动作力		0.35N max.			
页		29	30	31	32

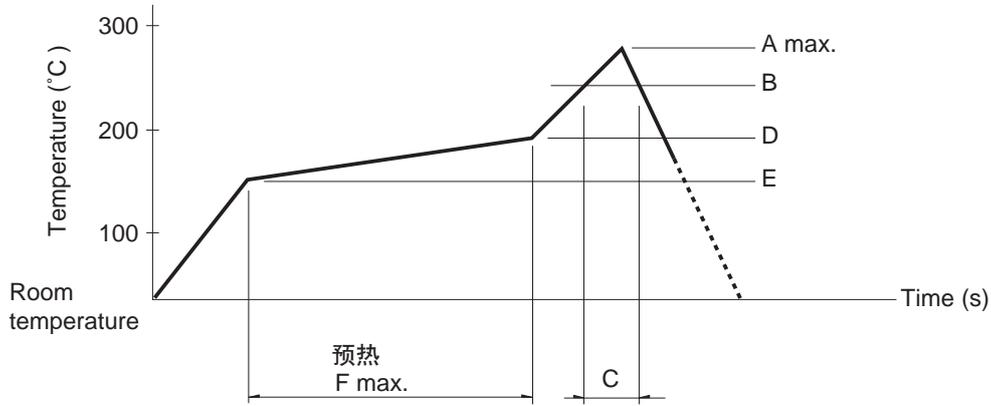
检测开关焊接条件	68
使用检测开关时的注意事项	69

注

表中的 ● 符号表示适用于系列内的全部产品。

回流方式的参考举例

1. 加热方式远红外线加热的上下加热方式。
2. 温度测量方式用 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ 的CA (K) 或CC (T) 进行测量。在焊接的连接部位置 (铜箔面) 测量, 固定方式使用耐热载带。
3. 温度分布



系列 (回流型)	A (°C) 3s max.	B (°C)	C (s)	D (°C)	E (°C)	F (s)
SPPB	250	230	40	180	150	120
SPVE	260					
SPVL						
SPVM						
SPVN						
SPVR						
SPVS						
SPVT						
SSCM						
SSCQ						
SPVQC	250					

注

1. 上述条件, 为印刷电路板的零部件表面的温度。根据电路板的材质, 大小, 厚度等, 电路板温度和开关表面温度会有很大的不同, 关于开关表面温度, 也请在上述条件内使用。
2. 根据贴面焊槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。

手工焊接方式的参考举例

项目	焊接温度	焊接时间
SPVS, SPVN, SSPVT, SPVM, SPVR, SPVE, SSCQ, SSCM, SPVL, SSCT, SPVQC	350±5°C	3s max.
SPVQ3, SPVQ6, SPVQ7, SPVQ8, SPVQ9, SSCN, SPVQA	300±10°C	3+1/0s
SPPB (Reflow)	350±5°C	5s max.
SSCF, SPPB (For Lead, Dip)	350±10°C	3+1/0s

浸焊方式的参考举例

适用于 For PC board 端子型

项目	项目		浸焊	
	预热温度	预热时间	焊接温度	焊接浸渍时间
SSCT, SPVQ3, SPVQ6, SPVQ7, SPVQ8, SPVQ9, SPVQA	100±10°C	60s max.	260±5°C	5±1s
SPPW8, SPPB	100 °C max.	60s max.	255±5°C	5±1s
SSCF	—	—	260±5°C	5±1s